

手动晶圆级真空贴压膜机-真空压膜机-PCB压膜机|屹立芯创

产品名称	手动晶圆级真空贴压膜机-真空压膜机-PCB压膜机 屹立芯创
公司名称	南京屹立芯创半导体科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火北路11号1楼
联系电话	4000202002 13327802009

产品详情

真空压膜通常是指在设备的真空模块内将干膜材料与基材进行贴合，完成加热压膜动作，常见的真空压膜机通常都是采用单段加压覆膜以及预贴膜的方式，但该方式对于表面具有许多细微凹凸结构的晶圆（如高深宽比TSV孔洞、高密度Cu Pillar Bump等）无法满足其高深宽比结构的干膜填覆的晶圆级封装需求；另外，先裁膜预贴合再热压的工艺，往往会导致无法完全排除的气泡空洞现象。

ELEAD TECH（屹立芯创）的全自动/半自动/手动型晶圆级真空贴压膜系统，区别于传统使用滚轮压式的贴膜机，采用真空贴膜+压膜后切膜的技术。干膜先预铺设（不与基材接触），腔体抽真空后进行贴膜，配合以震荡式软性气囊的多段热压作用，尤其适合晶圆表面具有凹凸起伏结构图案的贴压膜制程。如：Flip Chip制程的NCF压膜、Fan-out制程的Mold sheet压膜以及3D-IC制程所需的TSV填孔等。可实现近乎完美无气泡且高深宽比（1:20）填充的贴压膜；可兼容匹配8”及12”晶圆封装工艺。内部搭配自动切割系统，压膜后设备切割系统进行裁膜，匹配多种干膜材料，还可扩充压膜腔体进行二次表面整平压合，无须另外加装整平系统，节省成本。另外，手动型号还可铺设离型膜，可避免压膜中所造成的残胶影响。